

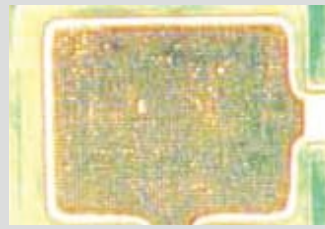
【特徴】金の纯度、电镀金、FLASH 金、化学沉金、光泽等与指定标准不相同的缺陷。

【起因・判断ポイント・発生工程】The purity of gold, the type of gold plating, such as flashed, electrolytic, electroless, lustrous or mat finish, etc., do not meet the specified requirement.

【原因、判断要点、发生工序】金めっき指示ミスや条件設定ミスなどにより出来たもの（金めっき指定指示段階、金めっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】镀金的指示错误、或者条件设定错误等所引起的（镀金指示制订阶段、镀金工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by mistakes in instruction or setting of plating conditions on gold plating. (Engineering section, plating process)



【コメント】つや消し金めっきを光沢金めっきと取り違い顕微鏡倍率×80

【注釋】把亚光镀金层弄错为光泽镀金层
显微镜倍率 ×80

【Comments】Lustrous gold plating is erratically used for mat gold plating
Magnification: ×80



【コメント】光沢金めっきをつや消し金めっきと取り違い顕微鏡倍率×80

【注釋】把光泽镀金层弄错为亚光镀金层
显微镜倍率 ×80

【Comments】Mat gold plating is erratically used for lustrous gold plating
Magnification: ×80

4-2-3 下地状態異常起因／基底的状态异常 / Caused by defective basis metal

4-2-3-1 金めっき下地打痕／镀金层的基底有压痕 / Dent on gold plating basis metal

【特徴】金めっき下地に打痕が見られる状態の欠陥

【特征】在镀金层的基底有压痕的缺陷。

【Characteristics】A dent is observed on the basis metal of gold plating.

【原因・判断ポイント・発生工程】金めっき端子部に浅い打痕が存在し、その上に金めっきされたことにより出来たもの（金めっき前工程）

【原因、判断要点、发生工序】镀金插脚有浅的压痕，其上面镀金所引起的（镀金前工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】There is a shallow dent on the gold edge board contact area and gold is plated on the dent. (Before gold plating process)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×